

2024 年 06 月 16 日
电子

SDIC

行业周报

证券研究报告

AI iPhone 时代开启，半导体产业景气周期向上

Apple intelligence 正式发布，有望助推苹果终端销量回暖：

6 月 11 日，苹果在 WWDC24 大会上正式发布个人智能化系统 Apple Intelligence，将生成式 AI 模型置于 iPhone 和 iPad 核心之中。1) 核心功能：Apple Intelligence 可以让设备理解并生成语言和图像，并可以代替人执行跨 APP 操作。其内置端侧语义索引，可识别个人数据并传输给生成式模型，根据个人情景更好去协助用户。2) Siri：将利用 Apple Intelligence 改进任务执行能力，用户与 Siri 的交互将变得更自然，可以连续对话和理解上下文内容，感知屏幕内容，还支持跨应用程序的操作。3) 外部大模型：Siri 支持调用 ChatGPT，针对文字、照片、文档、PPT、PDF 等可以直接提问。每次调用 ChatGPT 时，Siri 都需要征求用户的同意。4) 隐私保护：苹果创造了 Prostate Cloud Compute 私密云计算技术，可以让智能系统扩展引入更大的云端模型，同时实现隐私保护。苹果也无法访问这些数据，只能用来执行请求。5) 落地时间/机型：Apple Intelligence 在 iOS 18、iPadOS 18 及 macOS Sequoia 免费提供，在 iPhone 15 Pro、配备 M1 芯片的 iPad 和 Mac 以及后续机型上提供。此外大会还详细介绍了 iOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11 等操作系统的重大更新，在未来为苹果设备用户提供更加智能、便捷和个性化的服务。AI 赋能下的苹果终端有望迎来更多创新的落地，提升用户体验，提振产品销量，建议关注后续苹果产业链投资机会。

大摩报告称华虹或提价 10%，半导体产业景气信号增强：

6 月 13 日，Morgan Stanley 发布有关晶圆代工成熟制程产业报告，提及华虹半导体的晶圆厂利用率已超过 100%，下半年可能涨价 10%，使得与台厂间的价格差距缩小，产业价格竞争压力因此减缓。Morgan Stanley 据此上调华虹半导体评级至超配，目标价上调约 65%至 28 港元；调升世界先进、力积电目标价，并将评等都调高至中立。此前 5 月中芯、华虹公布的 24Q1 财报中，营收和毛利率均超指引，产能利用率环比实现较大提升，反映出晶圆代工产业需求呈现逐步向好的趋势。放眼整体半导体产业，WSTS 最新预测上调 2024 年全球半导体市场规模至 6112 亿美元，同比增长 16%，预计 2025 年将继续增长 12.5%至 6874 亿美元；SIA 数据显示，今年以来全球半导体销售额每月均实现两位数同比增长。国内来看，SEMI 报告显示，24Q1 中国大陆市场半导体设备销售额达到 125.2 亿美元，同比增长 113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场；政策方面，大基金三期正式成立，注册资本达 3440 亿元，其中六大行持股约 33%，预计三期将重点针对“卡脖子”环节，投向半导体零部件/设备/材料、存储、AI 等，进一步助推半导体产业链国产化进程。

投资评级 **领先大市-A**
维持评级

首选股票	目标价（元）	评级
------	--------	----

行业表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	7.3	0.7	-4.7
绝对收益	4.1	0.1	-13.1

马良 分析师

SAC 执业证书编号：S1450518060001

maliang2@essence.com.cn

相关报告

WSTS 上调半导体市场预期，	2024-06-10
WWDC/ COMPUTEX 引领端侧 AI 落地	
大基金三期成立，半导体国产替代有望加速	2024-06-02
英伟达业绩/指引超预期，微软新 Surface 打响 Copilot+PC 第一枪	2024-05-26
GPT-4o/Gemini 推动端侧 AI 落地，玻璃基板封装有望加速渗透	2024-05-19
中芯/华虹业绩超指引，AI 有望赋能苹果终端	2024-05-12

目 电子本周涨幅 4.67% (2/31)，10 年 PE 百分位为 39.46%:

(1) 本周 (2024.06.11-2024.06.14) 上证综指下降 0.61%，深证成指下降 0.04%，沪深 300 指数下降 0.91%，申万电子板块上升 4.67%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 2/31。2024 年，电子板块累计下降 8.19%。(2) 印制电路板在电子行业子板块中涨幅最高，为 9.83%；面板跌幅最大，为 -0.08%。(3) 电子板块涨幅前三公司分别为安路科技 (+44.46%)、逸豪新材 (+39.51%)、东晶电子 (+38.46%)，跌幅前三公司分别为 *ST 超华 (-17.91%)、中晶科技 (-6.60%)、芯联集成-U (-5.54%)。(4) PE：截至 2024.06.14，沪深 300 指数 PE 为 11.54 倍，10 年 PE 百分位为 36.99%；SW 电子指数 PE 为 38.15 倍，10 年 PE 百分位为 39.46%。

目 投资建议:

苹果产业链建议关注立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、兆易创新等；半导体设备零部件建议关注北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材；半导体材料建议关注路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、华特气体、彤程新材、华海诚科等；晶圆代工建议关注中芯国际、华虹半导体。

目 风险提示:

下游需求不及预期风险；技术迭代不及预期风险；国际科技博弈力度加大风险。

目 内容目录

1. 本周新闻一览.....	4
2. 行业数据跟踪.....	5
2.1. 半导体: ASML 最新路线图曝光, 计划 2030 年推出 Hyper-NA EUV.....	5
2.2. SiC: 英飞凌 8 英寸 SiC 晶圆厂一期建设完成, 预计年底投产.....	6
2.3. 消费电子: Q2 智能机出货或季减 5-10%, 鸿蒙份额超 iOS 跃居国内第二.....	7
3. 本周行情回顾.....	8
3.1. 涨跌幅: 电子排名 2/31, 子板块中印制电路板涨幅最高.....	8
3.2. PE: 电子指数 PE 为 38.15 倍, 10 年 PE 百分位为 39.46%.....	9
4. 本周新股.....	11

目 图表目录

图 1. 台积电月度营收	5
图 2. 世界先进月度营收	5
图 3. 联电月度营收	5
图 4. 新能源汽车产销量情况	6
图 5. 光伏装机情况	6
图 6. 国内智能手机月度出货量	7
图 7. 国内智能手机月度产量	7
图 8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额.....	7
图 9. Steam 平台 VR 月活用户占比.....	7
图 10. 本周各行业板块涨跌幅 (申万一级行业分类)	8
图 11. 本周电子板块子板块涨跌幅 (申万二级行业分类; %)	8
图 12. 本周电子板块子板块涨跌幅 (申万三级行业分类)	8
图 13. 本周电子板块涨幅前十公司 (%)	9
图 14. 本周电子板块跌幅前十公司 (%)	9
图 15. 电子板块近十年 PE 走势	9
图 16. 电子板块近十年 PE 百分位走势	10
图 17. 电子板块子板块近十年 PE 走势	10
图 18. 电子板块子板块近十年 PE 百分位走势	10
表 1: 本周电子行业新闻一览	4
表 2: 本周 IPO 审核状态更新	11
表 3: 本周重点 IPO 动态	11

1. 本周新闻一览

表1：本周电子行业新闻一览

赛道	日期	来源	内容
半导体	6月12日	TrendForce 官微	TrendForce: 24Q1 全球前十大晶圆代工产值 292 亿美元 (qoq-4.3%)。台积电市占率 61.7% (yoy+0.5pct)，仍居晶圆代工市场龙头地位；三星受手机市场疲软影响，市占率 11% (yoy-0.3pct)，与第一名差距拉至 50.7 个百分点；中芯国际第三，市占率 5.7% (yoy+0.5pct)。
	6月13日	半导体行业观察	摩根士丹利：发布有关晶圆代工成熟制程产业报告，提及华虹半导体的晶圆厂利用率已超过 100%，下半年可能涨价 10%。大摩上调华虹半导体评级至超配，目标价上调约 65% 至 28 港元；调升世界先进、力积电目标价，并将评等都调高至中立。
	6月14日	IT之家	ASML：公布了更新一代 Hyper-NA EUV 光刻机的技术蓝图，计划 2030 年推出 Hyper-NA EUV 光刻机，数值孔径达到 0.75NA，目前仍处于开发的“早期阶段”。imec 指出这是 ASML 首次将 Hyper-NA EUV 加入其路线图。在此前 5 月的 ITF World 活动中，ASML 提及生产率将提高到每小时 400-500 片晶圆。
AI	6月11日	智东西	苹果：在 WWDC 正式发布个人智能化系统 Apple Intelligence，实现让设备理解并生成语言和图像，并可以代替人执行跨 APP 操作。其内置端侧语义索引，可识别个人数据，设定个人情景，更好协助用户。Siri 可以更加自然地完成对话，具备感知屏幕内容和跨应用的功能；支持调用 ChatGPT，通过多种形式进行提问。此外苹果通过 Private Cloud Compute 大力保护使用者的隐私安全。
	6月11日	中关村在线	TechInsights：其最新数据显示，2023 年英伟达数据中心 GPU 出货量约为 376 万片，比 2022 年增长近 100 万片。英伟达以 362 亿美元的收入占据了 98% 的市场份额，是 2022 年的三倍，公司处于全球绝对领先地位。
	6月13日	芯智讯 集微网	三星：宣布了其强化工艺技术路线图，包括两个新的尖端节点 SF2Z 和 SF4U，以及利用其代工、内存和高级封装 (AVP) 业务独特优势的集成三星人工智能解决方案平台。公司预测，到 2028 年其 AI 相关客户名单将扩大 5 倍，收入将增长 9 倍。此外，三星电子总裁李在镕本周在美国会见了 Meta、高通和亚马逊的负责人，商讨合作事宜，讨论话题包括 AI、云服务和芯片。
	6月14日	第一财经	英伟达：全新发布的开源模型 Nemotron-4 340B 包括基础模型 Base、指令模型 Instruct 和奖励模型 Reward。英伟达使用了 9 万亿个 token（文本单位）进行训练。英伟达称开发人员可使用该系列模型生成合成数据，用于训练大型语言模型 (LLM)。
SiC	6月14日	集邦化合物半导体	英飞凌：完成了位于马来西亚居林的 8 英寸碳化硅晶圆厂第一阶段建设。计划于今年 8 月正式启用居林 Module 3 厂区，并于 2024 年底开始生产 SiC。目前，SiC 产线的生产设备正在安装中，晶圆厂气体的设计可适应新型设备、产量和结构要求。
汽车电子	6月12日	新京报	欧盟委员会：宣布将对从中国进口的电动汽车最高加征 38.1% 的额外关税，并称如果欧盟无法与中方通过谈判达成解决方案，征收临时关税的举措将从 7 月 4 日起生效。中国商务部新闻发言人回应，中方敦促欧盟立即纠正错误做法，通过对话协商妥善处理经贸摩擦。
	6月14日	观察者网	特斯拉：举行公司 2024 年股东大会。特斯拉 CEO 马斯克在会上宣布特斯拉面向未来的多项布局，包括将推出三款新车、推出 Robotaxi 业务、升级 FSD，以及在工厂部署更多的人型机器人 Optimus。汽车产品端，马斯克称新款 Model 3 高性能版本将于 6 月迎来交付；预计年底前电动车总产量将突破 700 万辆；超充网络建设上，今年部署力度将超越整个行业，预计将投入 5 亿美元；储能领域，年增长率将达到 200%-300%，并将推出 Megapack 3。
消费电子	6月14日	TrendForce 官微	TrendForce: 24Q1 全球智能手机总出货量为 2.96 亿部 (yoy+18.7%)，预计下一季度受到消费高通胀及国际形势冲突等因素的影响，出货量将环比下降 5-10%。24Q1 全球出货量前六名的厂商依次为三星 (20.1%)、苹果 (16.2%)、小米 (13.9%)、OPPO (11.4%)、传音 (10.1%)、vivo (7.3%)。
	6月14日	电子工程专辑	Counterpoint：截至 24Q1，鸿蒙 OS 在中国的市场份额已超越苹果 iOS，稳居第二位。在中国地区，鸿蒙 OS 的市场份额增至 17% (yoy+9pct)，iOS 下滑至 16% (yoy-4pct)；在全球范围内，鸿蒙 OS 的市场份额实现翻倍增长，从 2% 跃升至 4%。

资料来源：国投证券研究中心整理

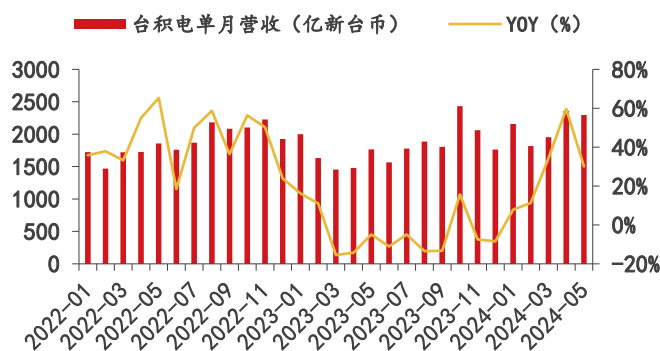
2. 行业数据跟踪

2.1. 半导体：ASML 最新路线图曝光，计划 2030 年推出 Hyper-NA EUV

ASML 近日公布了更新一代 Hyper-NA EUV 光刻机的技术蓝图，首次将 Hyper-NA EUV 加入其路线图。公司计划 2030 年推出 Hyper-NA EUV 光刻机，数值孔径达到 0.75 NA，目前仍处于开发的“早期阶段”。设备生产效率方面，ASML 刚出货的 High-NA EUV 光刻机（EXE:5000），目前的生产速度仅每小时 150 片晶圆，预计 2026 年左右将提升到每小时约 200 片晶圆，届时公司也会推出第二代的 High-NA EUV 光刻机（EXE:5200B）。在此前 5 月的 ITF World 活动中，ASML 提及会将 Hyper-NA EUV 光刻机生产效率提升到每小时 400-500 片晶圆。

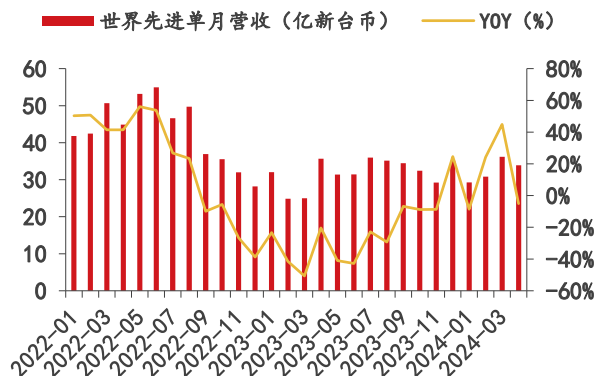
2024 年 5 月台积电单月营收 2296.20 亿新台币，同比增长 30.07%，环比下降 2.71%。世界先进 2024 年 4 月营收 33.88 亿新台币，同比下降 5.07%，环比下降 6.42%。联电 2024 年 5 月营收 195.09 亿新台币，同比增长 3.89%，环比下降 1.18%。

图1. 台积电月度营收



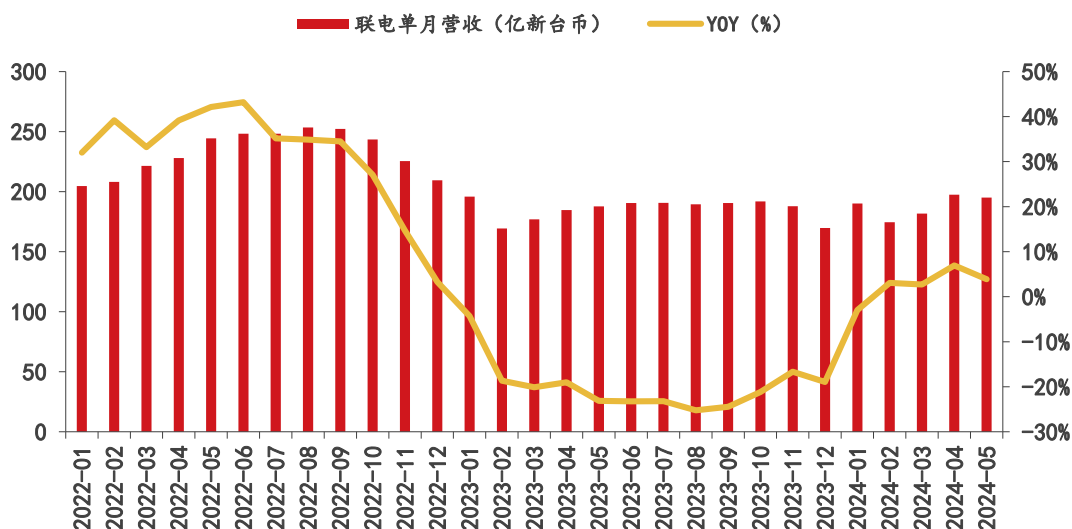
资料来源：台积电公司官网，国投证券研究中心

图2. 世界先进月度营收



资料来源：世界先进公司官网，国投证券研究中心

图3. 联电月度营收



资料来源：联电公司官网，国投证券研究中心

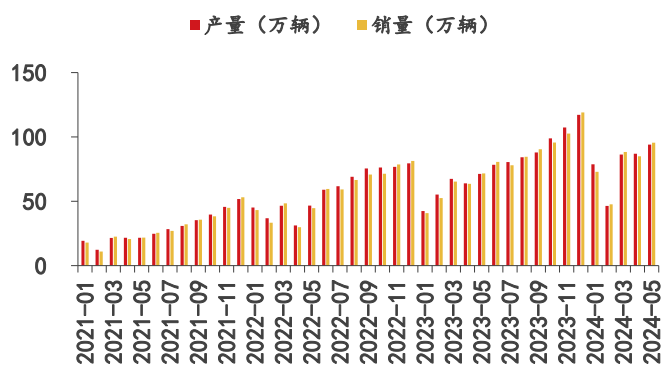
2.2. SiC: 英飞凌 8 英寸 SiC 晶圆厂一期建设完成, 预计年底投产

英飞凌于近日完成了位于马来西亚居林的 8 英寸碳化硅晶圆厂第一阶段建设, 计划于今年 8 月正式启用居林 Module 3 厂区, 并于 2024 年底开始生产 SiC。目前, SiC 产线的生产设备正在安装中, 晶圆厂气体的设计可适应新型设备、产量和结构要求。上周公司已获得其位于德国德累斯顿的智能功率半导体工厂的最终建设许可, 工厂价值 50 亿欧元。此前英飞凌表示, 在未来五年内, 公司将再投入多达 50 亿欧元进行居林 Module 3 厂区的二期建设。公司希望随着马来西亚的居林超级工厂在 2024 年底投产, 最终带动其碳化硅营收于 2030 年达到 70 亿欧元, 并占据全球 30% 碳化硅器件市场份额。

由中汽协公布的新能源车产销量数据, 2024 年 5 月, 国内新能源汽车产量由去年 71.3 万辆增长至 94.0 万辆, 销量由去年 71.65 万辆增长至 95.5 万辆。5 月产销量仍保持同比增长, 汽车消费端动能不减。

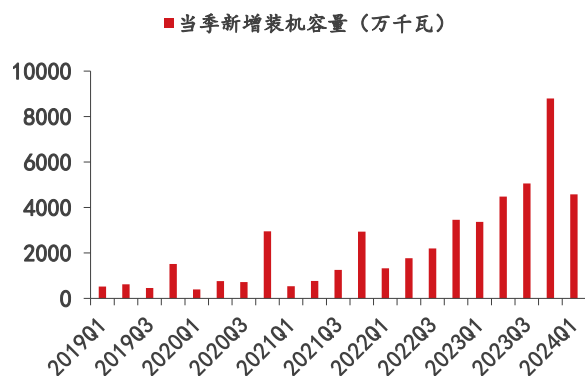
光伏方面, 国内近年来季度光伏安装量增长迅速, 据国家能源局发布的全国电力工业统计数据, 2024Q1 国内光伏新增装机达到 45.74GW, 环比减少 47.99%, 同比增长 35.89%。光伏产业的迅速发展同样能够带动对第三代半导体 (碳化硅) 功率器件的需求。

图4. 新能源汽车产销量情况



资料来源: 中国汽车工业协会, Wind, 国投证券研究中心

图5. 光伏装机情况



资料来源: 国家能源局, 国投证券研究中心

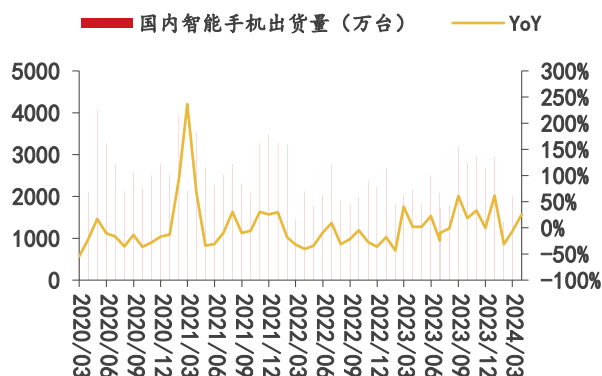
2.3. 消费电子：Q2 智能机出货或季减 5-10%，鸿蒙份额超 iOS 跃居国内第二

TrendForce 集邦咨询数据显示，24Q1 全球智能手机总出货量为 2.96 亿部 (yoy+18.7%)，预计下一季度受到消费高通胀及国际形势冲突等因素的影响，出货量将环比下降 5-10%。出货量前六名的厂商依次为三星 (20.1%)、苹果 (16.2%)、小米 (13.9%)、OPPO (11.4%)、传音 (10.1%)、vivo (7.3%)。

Counterpoint 最新报告称，截至 24Q1，鸿蒙 OS 在中国的市场份额已超越苹果 iOS，稳居第二位。在中国地区，鸿蒙 OS 的市场份额增至 17% (yoy+9pct)，iOS 下滑至 16% (yoy-4pct)。在全球范围内，鸿蒙 OS 的市场份额实现翻倍增长，从 2% 跃升至 4%，而安卓和 iOS 的市场份额则均有轻微下滑，同比分别下降 1pct。

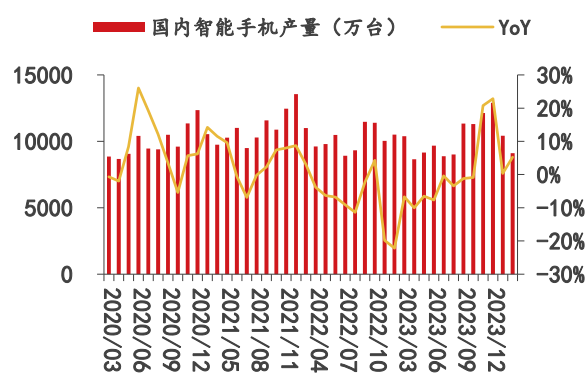
智能手机：据中国信通院，2024 年 4 月中国智能手机出货量为 2266.80 万台 (YoY+25.5%，MoM+12.1%)；据国家统计局，2024 年 4 月中国智能手机产量为 9104 万台 (YoY+5.3%，MOM-12.6%)。

图6. 国内智能手机月度出货量



资料来源：Wind，中国信通院，国投证券研究中心

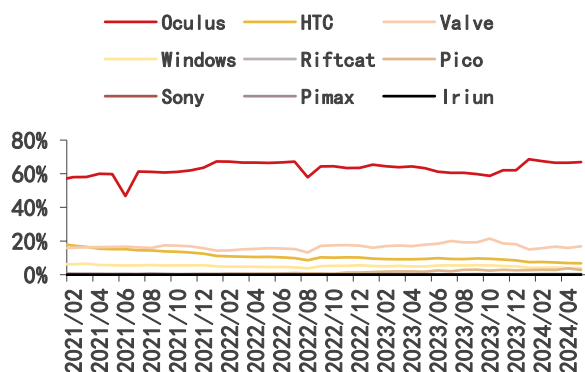
图7. 国内智能手机月度产量



资料来源：Wind，国家统计局，国投证券研究中心

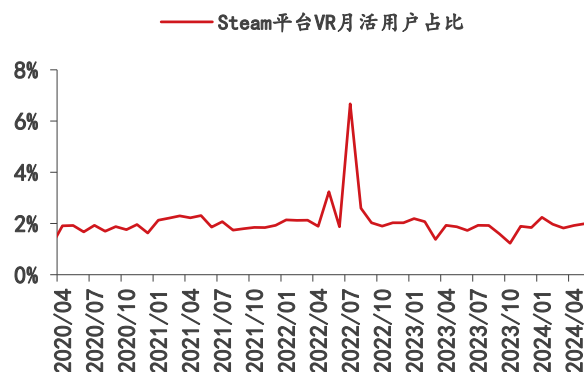
VR：据 Steam，2024 年 5 月 Oculus 在 Steam 平台的份额占比为 66.87%，YoY+3.54pct，MoM+0.36pct，而 Pico 份额占比为 2.79%，YoY+0.97pct，MoM-0.96pct；Steam 平台 VR 月活用户占比为 1.99%，YoY+0.12pct，MoM+0.07pct。

图8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额



资料来源：Steam，国投证券研究中心

图9. Steam 平台 VR 月活用户占比



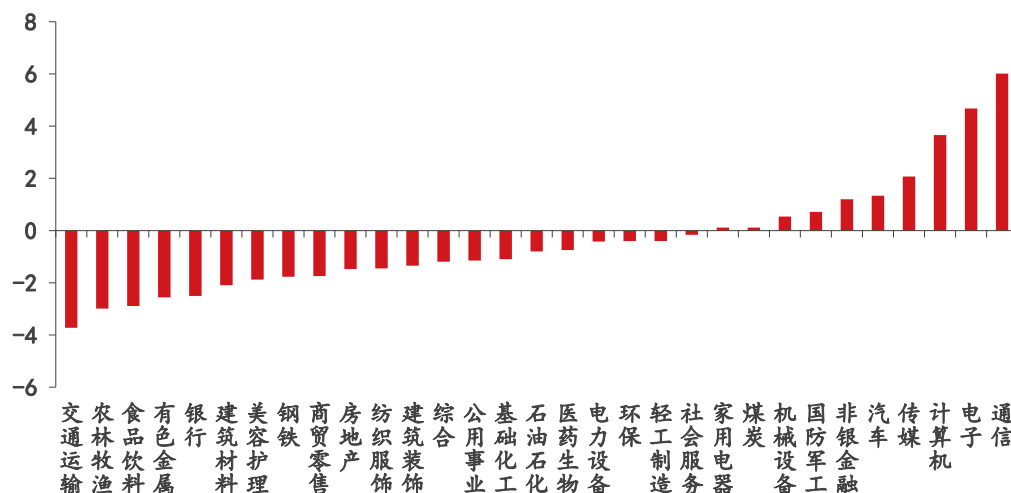
资料来源：Steam，国投证券研究中心

3. 本周行情回顾

3.1. 涨跌幅：电子排名 2/31，子板块中印制电路板涨幅最高

- 全行业：本周（2024.06.11-2024.06.14）上证综指下降 0.61%，深证成指下降 0.04%，沪深 300 指数下降 0.91%，申万电子板块上升 4.67%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 27/31。2024 年，电子板块累计下降 8.19%。

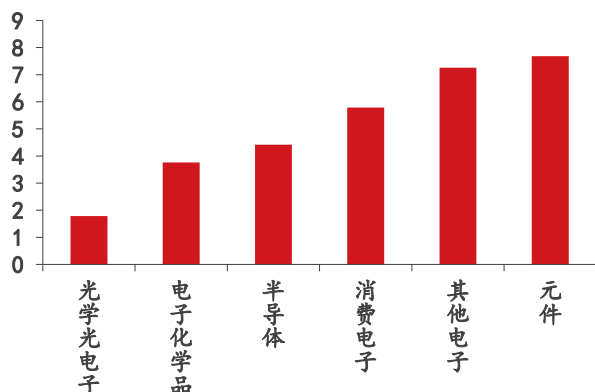
图10. 本周各行业板块涨跌幅（申万一级行业分类）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

- 电子行业：本周（2024.06.11-2024.06.14）元件在电子行业子板块中涨幅最高，为 7.68%；光学光电子涨幅最低，为 1.78%；进一步细分来看，印制电路板在电子行业子板块中涨幅最高，为 9.83%；面板跌幅最大，为-0.08%。

图11. 本周电子版块子版块涨跌幅（申万二级行业分类；%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

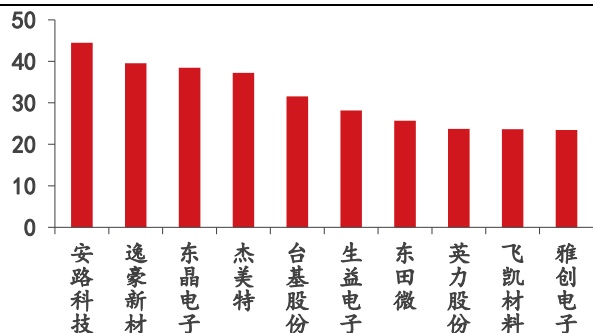
图12. 本周电子版块子版块涨跌幅（申万三级行业分类）

申万二级行业名称	周涨跌幅 (%)	申万三级行业名称	周涨跌幅 (%)
半导体	4.42	分立器件	6.70
		半导体材料	7.41
		数字芯片设计	6.14
		模拟芯片设计	6.64
		集成电路封测	1.91
		半导体设备	1.68
元件	7.68	印制电路板	9.83
		被动元件	2.84
光学光电子	1.78	面板	-0.08
		LED	3.78
		光学元件	5.88
其他电子	7.26	其他电子	7.26
消费电子	5.79	品牌消费电子	2.37
		消费电子零部件及组装	6.30
电子化学品	3.76	电子化学品	3.76

资料来源：Wind，国投证券研究中心

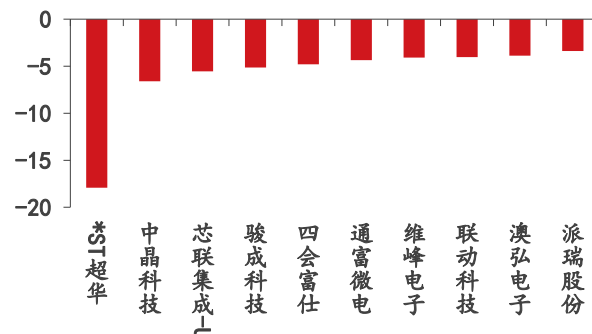
- 电子标的：本周（2024.06.11-2024.06.14）电子板块涨幅前三公司分别为安路科技（+44.46%）、逸豪新材（+39.51%）、东晶电子（+38.46%），跌幅前三公司分别为*ST超华（-17.91%）、中晶科技（-6.60%）、芯联集成-U（-5.54%）。

图13. 本周电子板块涨幅前十公司（%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

图14. 本周电子板块跌幅前十公司（%）

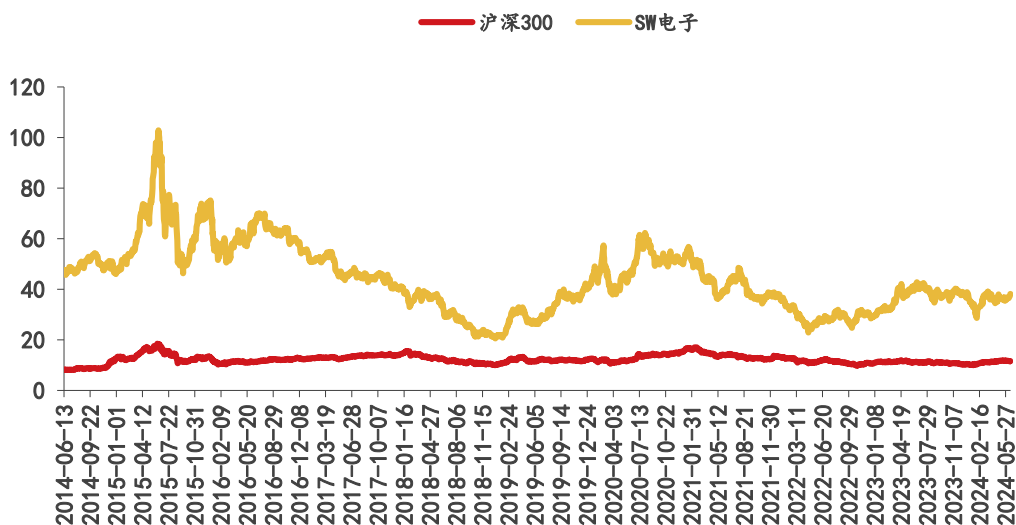


资料来源：Wind，国投证券研究中心

3.2. PE：电子指数 PE 为 38.15 倍，10 年 PE 百分位为 39.46%

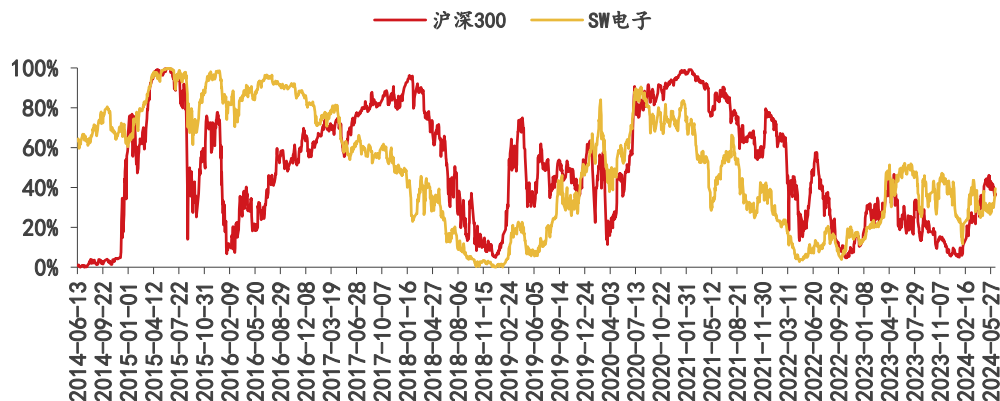
- 电子行业：截至 2024.06.14，沪深 300 指数 PE 为 11.54 倍，10 年 PE 百分位为 36.99%；SW 电子指数 PE 为 38.15 倍，10 年 PE 百分位为 39.46%。

图15. 电子板块近十年 PE 走势



资料来源：Wind，国投证券研究中心

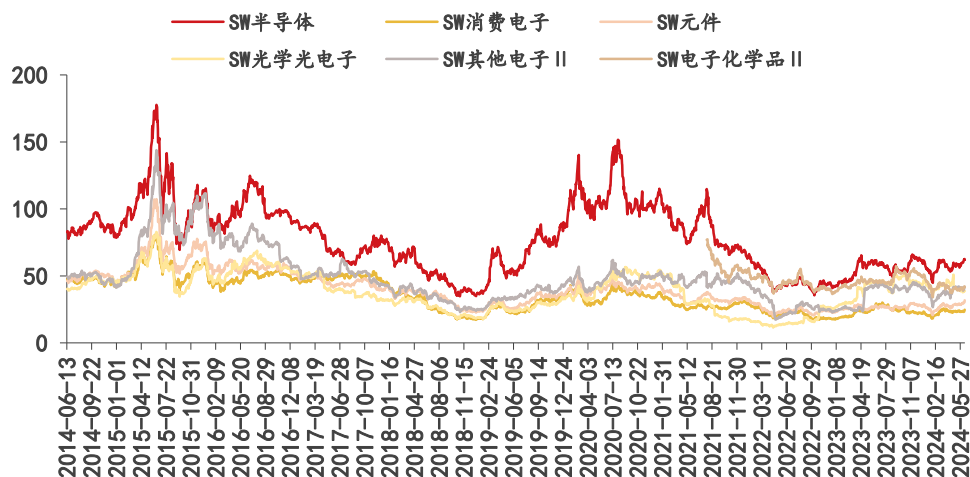
图16. 电子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

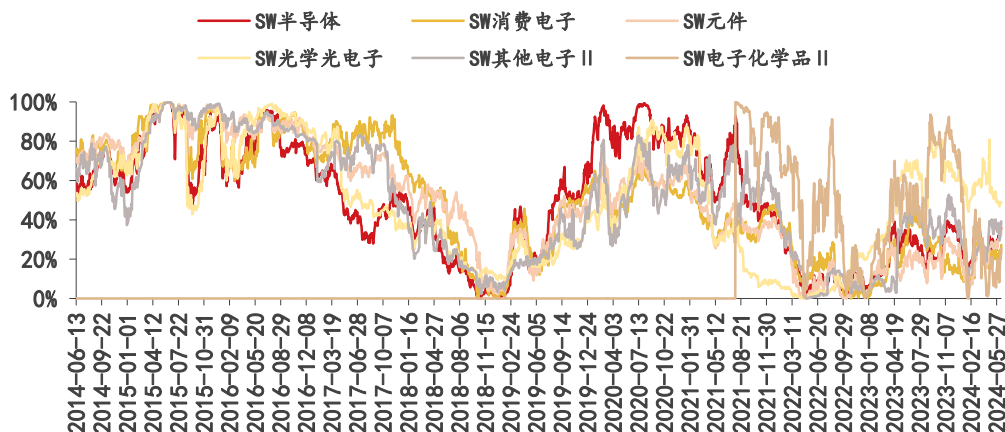
- 电子行业子版块: 截至 2024. 06. 14, 子行业子版块 PE/PE 百分位分别为半导体 (62.08 倍/35.47%)、消费电子 (24.76 倍/27.21%)、元件 (31.76 倍/36.00%)、光学光电子 (38.71 倍/48.79%)、其他电子 (41.69 倍/39.25%)、电子化学品 (41.65 倍/22.48%)。

图17. 电子版块子版块近十年 PE 走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

图18. 电子版块子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

4. 本周新股

表2：本周 IPO 审核状态更新

	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14
已受理					
已问询					
已回复				新恒汇	
已审核通过					
报送证监会					
证监会注册				联芸科技	
正在发行					

资料来源：Wind，国投证券研究中心

表3：本周重点 IPO 动态

联芸科技

公司简介

联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SOQ、芯片架构设计、算法设计、数字 IP 设计、模拟 IP 设计、中后鸿设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研究及产业化，已发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。公司基于自主的芯片设计研发平台，已形成多款 AIoT 信号处理及传输芯片的产品布局，并实现规模化商业应用。

公司开发的芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。经过多年技术积累与品牌沉淀，公司已进入客户 E、江波龙、长江存储、威刚、宜鼎、宇瞻、佰维、金泰克、时创意、金胜维等行业头部客户的供应链体系，并成为其在上游领域的主要供应商。

赛道分析

根据世界半导体贸易统计协会统计数据显示，2021 年全球存储芯片市场规模为 1,538.38 亿美元，同比增长 30.95%，预计 2022 年全球存储芯片市场规模将达到 1,716.82 亿美元。根据中国闪存市场发布的《2021 年全球 SSD 市场分析报告》数据，在独立固态硬盘主控芯片市场，2021 年联芸科技固态硬盘主控芯片出货量占比达到 16.67%，全球排名第二。公司依托长期积累形成的综合技术实力，开发出系列固态硬盘主控芯片产品和解决方案，并进入嵌入式存储主控芯片领域，形成丰富齐备的产品线，覆盖固态存储多应用场景。公司目前的消费级和工业级存储主控芯片产品与国内外行业主流产品的技术水平不存在明显差异，但在高端的企业级存储主控芯片及高端的 AIoT 信号处理及传输芯片的技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

随着 5G 技术的逐渐成熟，可实现的应用场景更加丰富和完善，各行各业“万物互联”的深度广度已经得到进一步拓展。根据 GSMA 数据，2021 年全球物联网终端设备连接数量接近 150 亿个，预计 2025 年全球物联网终端设备连接数量将达到 250 亿个。AIoT 芯片市场空间大、下游应用领域广、竞争较为激烈，公司首款 AIoT 信号处理及传输芯片于 2021 年开始批量出货，目前量产芯片共 3 款，处于起步阶段。公司根据 AIoT 信号处理及传输芯片的特点和要求，优化了系统架构；并依托高速数模混合信号芯片设计的积累，从技术门槛较高的感知接口和以太网物理层开展了 IP 自研。

募投项目

序号	募投金额（万元）	建设期	项目名称
1	46,565.64	2 年	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目
2	44,464.66	3 年	AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目
3	60,959.03	3 年	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目
4	53,000.00	-	补充流动资金
合计金额	204,989.33		

财务表现

(亿元)	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入	3.36	5.79	5.73	10.34
归母净利润	-0.04	0.45	-0.79	0.52

资料来源：Wind，国投证券研究中心整理

目 行业评级体系

收益评级：

领先大市 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%及以上；

同步大市 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%及以上；

风险评级：

A —— 正常风险，未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —— 较高风险，未来 6 个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

目 分析师声明

本报告署名分析师声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

目 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

国投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

 免责声明

何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国投证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

国投证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

国投证券研究中心**深圳市****地 址：** 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 33 楼**邮 编：** 518026**上海市****地 址：** 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层**邮 编：** 200080**北京市****地 址：** 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层**邮 编：** 100034